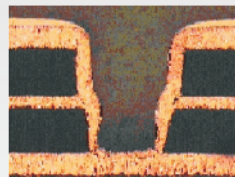
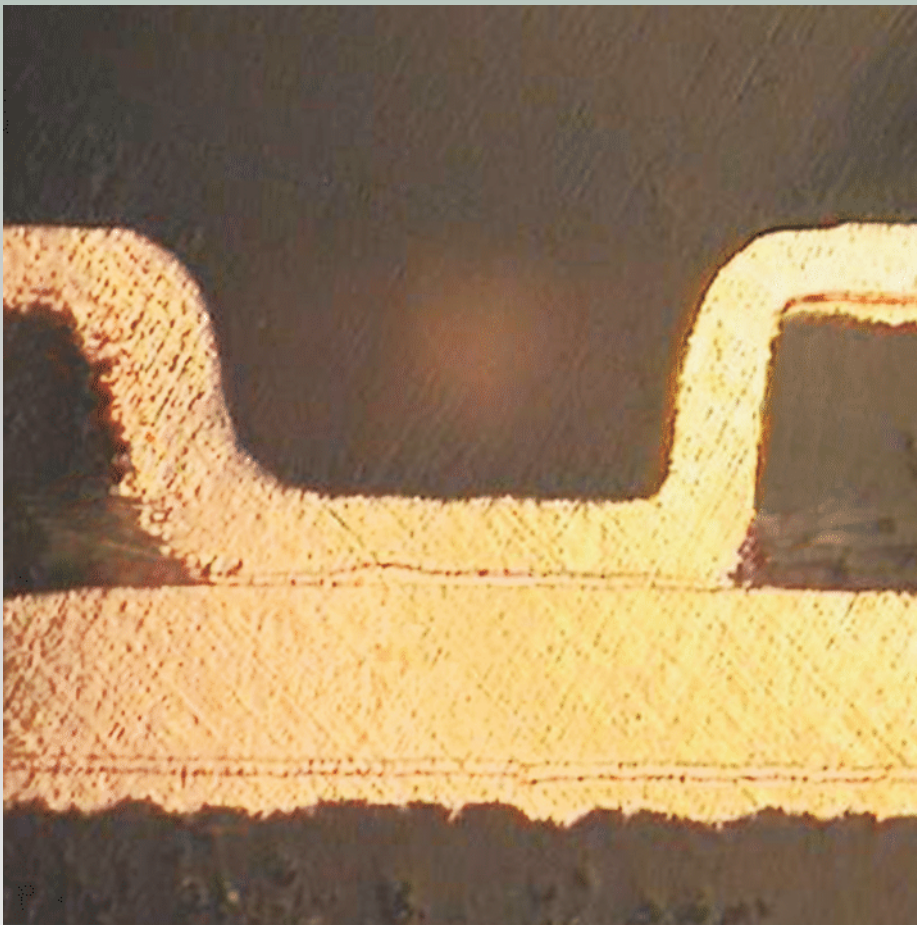


# CADiLAC Laser



- Microvias für HDI vom Spezialisten
- Alle LP-Materialien bohrbar
- Stufenbohrungen

# Laserbohren



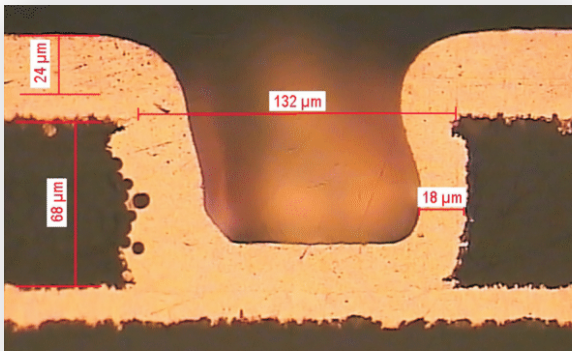
Seit mehr als 10 Jahren bietet CADiLAC Laser das Laserbohren als Dienstleistung an.

Unser Hybridlasersystem arbeitet im UV- und im CO<sub>2</sub>- Wellenlängenbereich. Dies erlaubt die Bearbeitung von sämtlichen, im Leiterplattenbereich, eingesetzten Materialien.

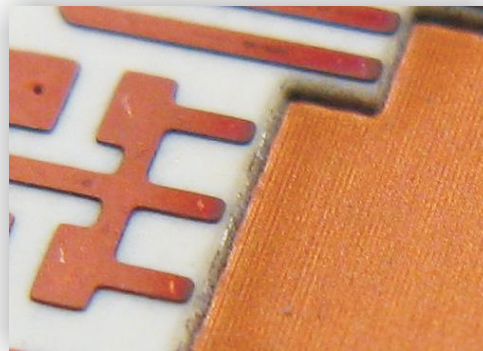
Das Lasersystem erlaubt auch das Konturbearbeiten und die Oberflächenstrukturierung (wie z. B. das Einbringen von Taschen) von Starr-Flexschaltungen.

### Folgende Angaben werden für Laser-Bohraufträge benötigt:

- Lagenaufbau:** Kupfer- und Prepregdicke des zu bohrenden Materials. Kupferdicke auf der Innenlage.
- Passermarken:** Form, Größe und Lage werden zur Positionierung und Anpassung des Bohrprogrammes benötigt.
- Bohrdaten:** Excellon II (bevorzugtes Datenformat)  
Andere Formate auf Anfrage.



*Beispiel: Socklochbohrung FR 4  
Einmessen + Laserbohren*



*Beispiel: Tasche  
Einmessen + Tiefenlasern*

### Technische Spezifikation:

- Bohrbares Material:** Cu-Folien, FR4, FR5, BT-Harze, Polyimid (Kapton), Rogers (Karamik oder teflongefüllte Harze), Cyanat Ester, Thermount-Aramid, LCP
- Bohrdurchmesser:** 50µm ... 220µm +/- 5µm
- Panelgröße:** max. 635 x 750mm
- Genauigkeit:** +/- 25µm über den gesamten Verfahrensbereich

# Laserbohren

Erstausgabe 08.05.2006, Stand 15.01.2013, Änderungen vorbehalten

**CADiLAC Laser**



CADiLAC Laser GmbH  
Boschring 2  
D-91161 Hilpoltstein  
Tel. +49 9174 4720-0  
Fax +49 9174 4720-50  
www.cadilac-laser.de  
info@cadilac-laser.de

